

T-8

无机镀层水溶型助焊剂



介绍

T-8是一种无机酸性助焊剂，它是活性非常强的锌铵类助焊剂。T-8是一种无烟、易燃的水溶性助焊剂，特别设计应用在浸焊工艺中恢复受污染铜表面的可焊性。镀锡的焊盘或其它金属盘表面优点在于有一种很厚的，无机的无空洞表层，合金层通过基础金属形成。Asahi的创新技术已经使T-8在热浸焊工艺中得到了发展应用。助焊剂残余物可以通过水洗完全冲刷干净，从而去除铜线表层的离子污染。

应用

铜线首先通过含有T-8的助焊剂罐，添加助焊剂之后，在进行镀锡工艺之前不需要进行预热，并且铜线表面通过湿布擦拭很容易清洁。

残余处理

焊接后的残余物是吸潮物质和离子化合物，在焊接后立即进行所有残余物的清理是必要的。残余物的清洁先在水温不低于40度时用水进行冲洗，之后再通过去离子水进行冲洗。

稀释剂

不需要稀释剂。

健康 & 安全

遵循使用处理准则，如：装置良好的通风系统及避免长久持续与皮肤接触。如需要更多资讯，请参看材料安全资料表。

存储

T-8在良好的储存环境中可存放长达6个月之久。

包装

20公斤容器。

规格

测试

测试	测试成绩
状态	液体
颜色	无色的
比重 @ 25°C	0.806 +/- 0.01
JIS Z 3197 8.2.2	
含固量 (110°C, 3小时)	2.0 +/- 0.5 wt%
IPC-TM-650 2.3.34	
JIS Z 3197 8.1.3	
卤化物含量	0.9 +/- 0.1 wt%
JIS Z 3197 8.1.4.2.1	
水萃取电阻率	> 1 x 10 ⁴ Ω-cm
JIS Z 3197 8.1.1	
铜腐蚀测试	通过
IPC-TM-650 2.6.15	
JIS Z 3197 8.4.1	
PH	2
闪点	17°C
扩散率	> 85% (SnPb)
JIS Z 3197 8.3.1.1	
焊点外观	> 80% (SnCu3及SnAg3.5) 光亮

DISCLAIMER OF LIABILITY

"All statements, information and recommendations contained in this catalog are based on data and test results which we consider, to the best of our knowledge and belief, to be reliable and informative to the users but the accuracy and completeness thereof is not guaranteed. No warranty, expressed or implied, statutory or otherwise, is given regarding the use of the information and products contained in this catalog since the conditions and suitability for use, handlings, storage or possession of the products are determined by the users and are therefore beyond our control. We shall not be liable in respect of any liabilities, losses (including consequential losses), damages, proceedings, costs, claims or injuries whatsoever sustained or suffered by the users (including any third parties) in connection with the use of the information, recommendation and the products contained in this catalog."

Singapore Asahi Chemical and Solder Industries Pte Ltd

47 Pandan Road Singapore 609288

Tel: +65 6262-1616 Fax: +65 6261-6311

Website: <http://www.asahisolder.com> Email: enquiry@sinasahi.com.sg